

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC

# 事業説明会

情報コンポーネント領域

2026年6月4日

情報コンポーネント領域長

大野 良次

本資料は、株主、投資家、ならびに報道関係者の皆様に当社の活動内容に関する情報を提供することを目的として作成しています。

### 将来情報についての注意事項

この資料に記載されております売上高及び利益等の計画のうち、過去または現在の実事に関するもの以外は、当社グループの各事業に関する業界の動向についての見通しを含む経済状況、ならびに為替レートの変動その他の業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報をもとにした当社グループの仮定及び判断に基づく見通しを前提としております。

これら将来予想に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しており、例として以下のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。

- ・ 米国、欧州、日本その他のアジア諸国等の経済情勢、特に個人消費及び企業による設備投資の動向
- ・ 米ドル、ユーロ、アジア諸国等の各通貨の為替相場の変動
- ・ 急速な技術革新と当社グループの対応能力
- ・ 財務的、経営的、環境的な諸前提の変動
- ・ 諸外国による現在及び将来の貿易規制等
- ・ 当社グループが所有する有価証券等の時価の変動

従いまして、実際の売上高及び利益等と、この資料に記載されております計画とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。なお、当社グループは、この資料の本リリース後においても、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。

### 著作権等について

この資料のいかなる部分についてもその著作権その他一切の権利は、古河電気工業株式会社に帰属しており、あらゆる方法を問わず、無断で複製または転用することを禁止します。

## 1. 情報コンポーネント領域の市場、基本方針

- 1-1. 市場概況
- 1-2. 2030年に向けた基本方針
- 1-3. 2026年度方針
- 1-4. 売上高・営業利益推移

## 2. 事業部門の成長施策、売上高推移予想

- 2-1. AT・機能樹脂事業部門
- 2-2. サーマル・電子部品事業部門
- 2-3. メモリーディスク事業部門
- 2-4. 銅箔事業部門
- 2-5. ファイテル製品事業部門
- 2-6. 光電融合デバイス事業部門

All to brighten the world

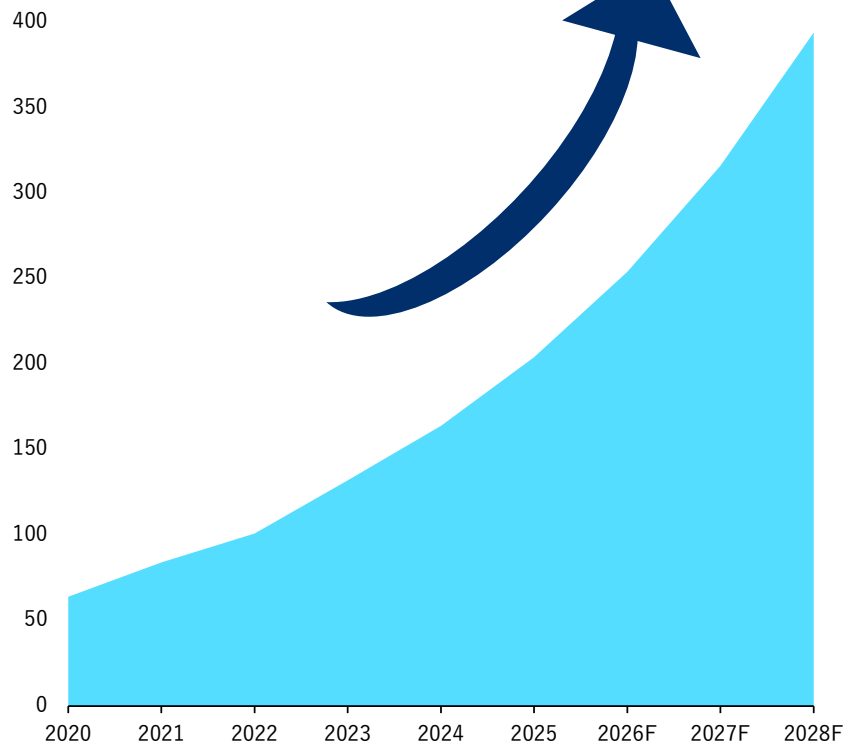
**FURUKAWA**  
ELECTRIC

# 情報コンポーネント領域の市場、基本方針

## AI・データセンタ関連市場に「差別化」「高性能」製品を提供

世界で生成されるデータ量およびデータトラフィックは今後も増大

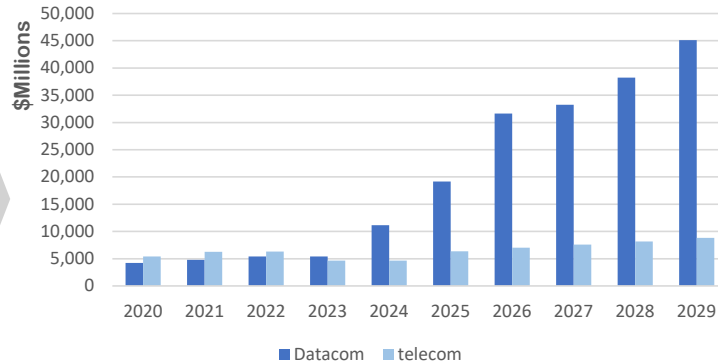
Data created and replicated worldwide  
(zettabytes)



(調査会社情報をもとに当社作成)

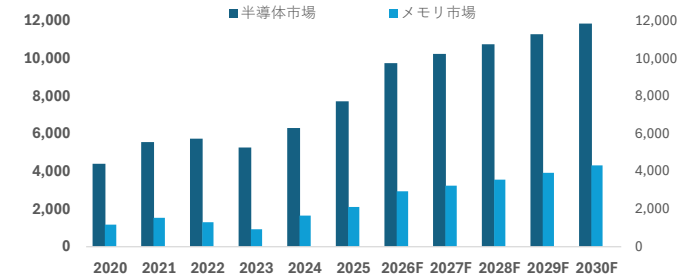
当領域の多くの事業、製品市場もこのデータ増大に伴い、中長期的に市場拡大する傾向に変化なし

光部品市場規模



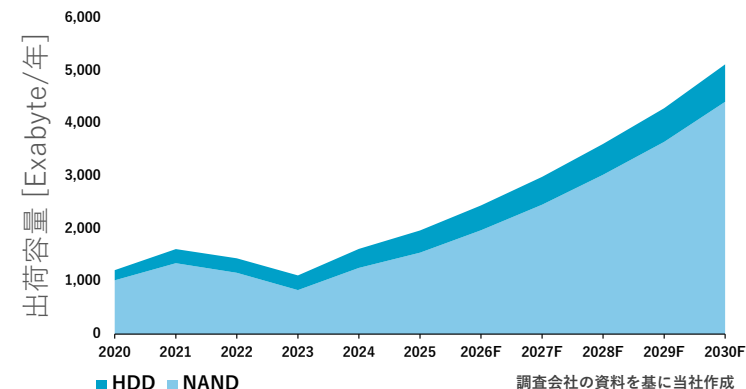
(調査会社情報をもとに当社作成)

半導体市場規模・メモリ市場規模



WSTS、Yole等のデータをもとに当社作成

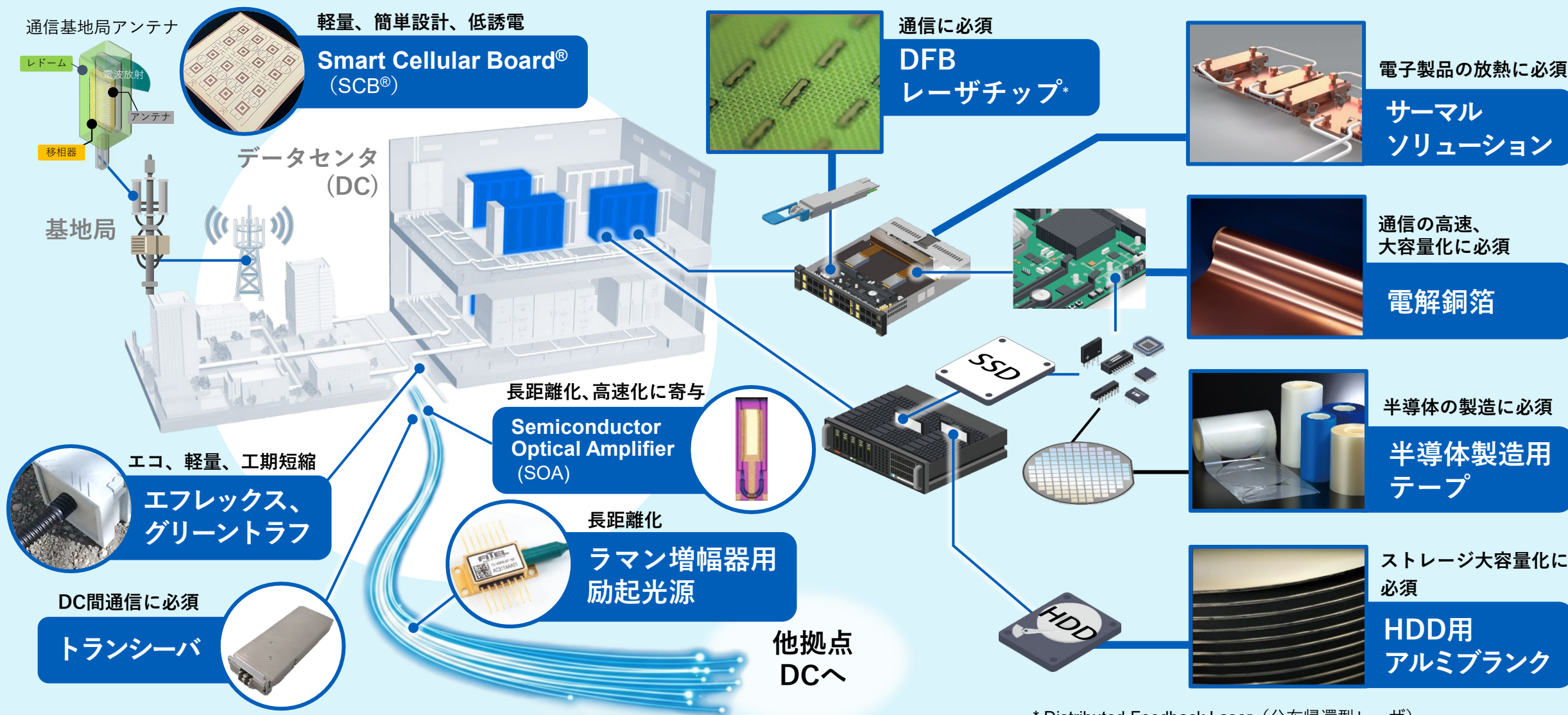
ストレージ別出荷容量推移



調査会社の資料をもとに当社作成

# 2030年に向けた基本方針

データセンタ(DC)関連市場に「高機能」「差別化」製品の開発・提供を継続し、成長を実現していく



\* Distributed Feedback Laser (分布帰還型レーザ)

## 情報コンポーネント領域全体

- ・ 「高機能」「差別化」製品の提案活動を継続し、新分野・新顧客を取り込むことで成長していく
- ・ データセンタ関連市場の変化に迅速に対応できる体制を構築する

### AT・機能樹脂事業

- ・ 半導体の最先端プロセス向け技術の開発推進、高付加価値品の先行参入、および横展開で売上拡大
- ・ トータル線路設計技術及び発泡技術を応用した製品群により、データセンタのインフラ構築の工期短縮に貢献
- ・ 環境配慮型製品の開発及び売上拡大

### サーマル・電子部品事業

- ・ コアパートナーとして顧客方針および要求に沿った差別化されたソリューションを提供し、顧客満足度を向上
- ・ 市場動向や技術トレンドに対応し、スピーディーかつプロアクティブに施策を実行する体制を構築し収益を拡大

### メモリーディスク事業

- ・ HDD 1台当たりの記録容量増ニーズの高まりに、薄型化を実現する差別化材料で対応
- ・ 短中期のKSFである高付加価値薄型の売上数量増

### 銅箔事業

- ・ お客様の要望変化に「迅速」に対応した製品開発を行い、将来拡大する市場に「高機能」・「差別化」した新製品を継続的に提供

### ファイテル製品事業

- ・ 増産投資と高出力レーザ技術により、データセンタ向け高付加価値品の需要を獲得
- ・ 供給能力の拡大により売上および収益を拡大

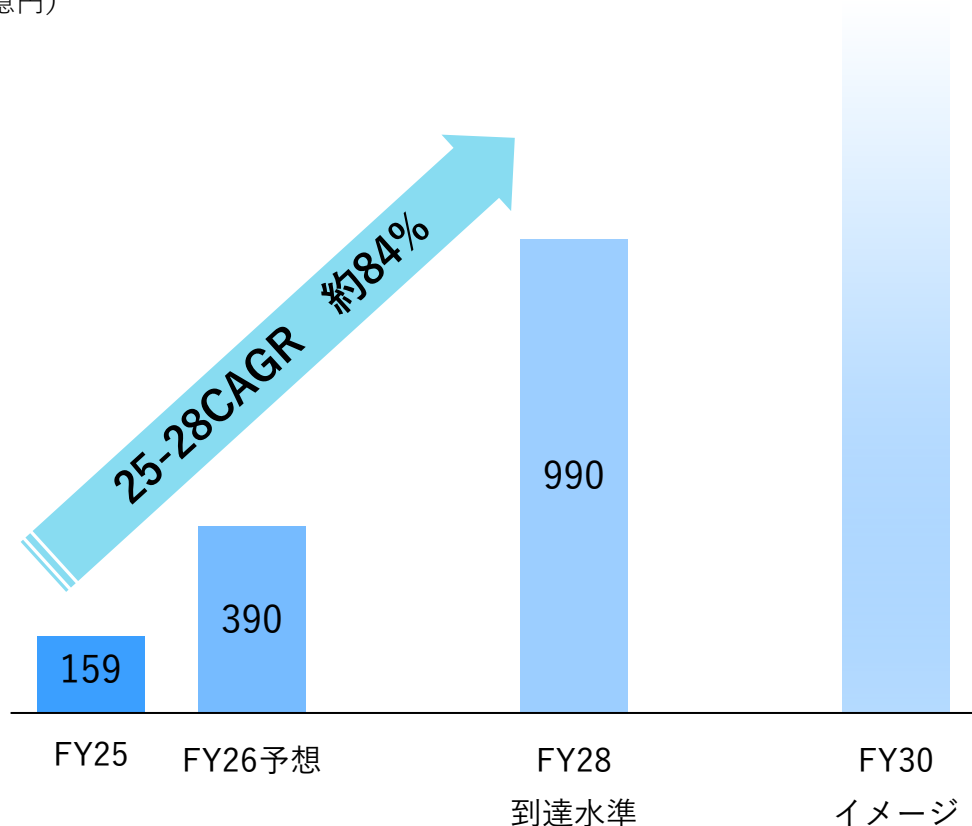
### 光電融合デバイス事業

- ・ 光電融合が進む市場に対し、変調器・トランシーバの市場開拓を進め、グローバルで存在感のある事業を確立

## 情報コンポーネント領域

### 営業利益

(億円)



### Point

- 2030年に向け、データセンタ関連市場の成長は継続する
- サーマル・電子部品、ファイテル製品両事業の大型投資を実行し、成長を実現する
- 新分野・新顧客への提案活動を推進し、市場変化を成長機会とし、事業拡大を目指す

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC

# 各事業部門の成長施策、売上高推移予想

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC

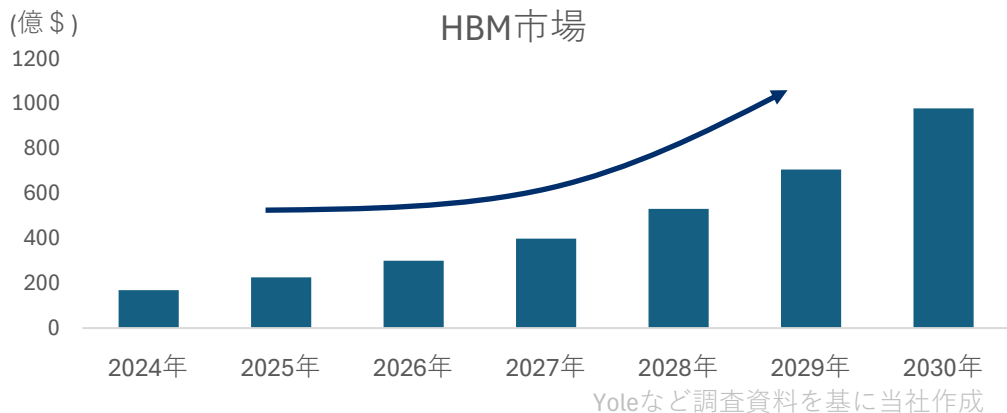
# AT・機能樹脂事業

AT・機能樹脂事業部門長

矢野 正三

## AI半導体などの先端プロセス向け高付加価値品に集中

### HBMに代表される、AI半導体向け需要の拡大



### 半導体デバイストレンドと課題

#### トレンド

#### 技術課題

#### ウエハ薄膜化

- チップの積層数の増加に伴うウエハの薄膜化
- ステルスダイシングに代表されるウエハの抗折強度を向上させる新プロセスの普及

- ✓ レーザを透過するための透明性
- ✓ ウエハ個片化時のチップ分割性
- ✓ ステルスダイシングへのプロセス対応性

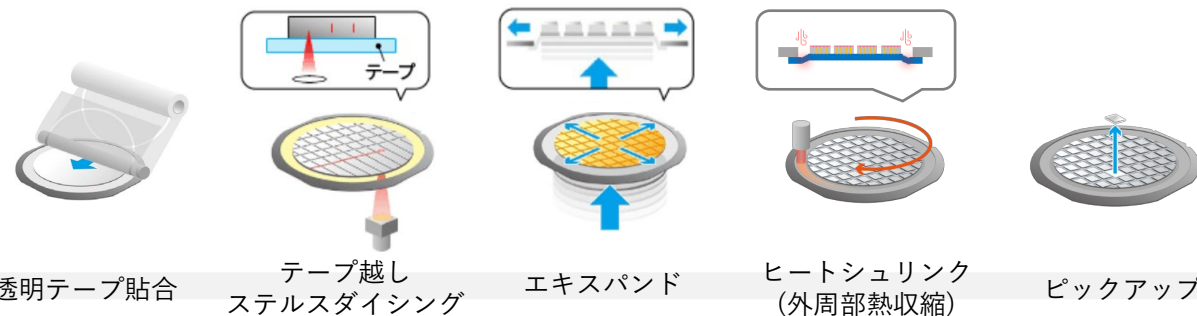
#### ウエハ表面多様化

- 2.5D、3Dパッケージの導入に伴うウエハ表面構造及び表面状態の複雑化

- ✓ 物理的、化学的に複雑な表面に対する糊残りとの両立
- ✓ 様々な表面に対する軽剥離性

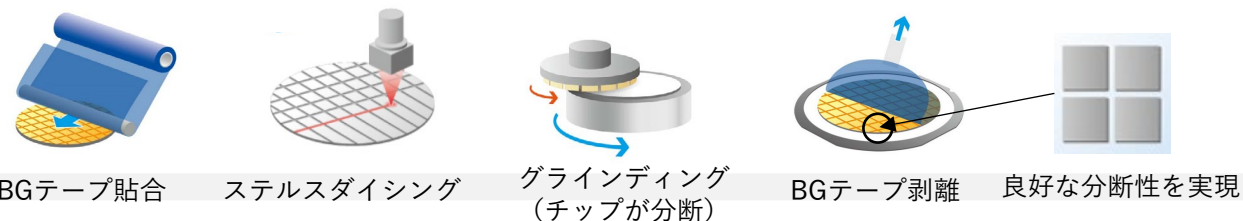
### HBM\*用透明DCテープ

- ✓ 高い透明性により、テープ越しレーザー照射によるウエハ個片化に対応
- ✓ 高いチップ分割性により、ステルスダイシングプロセスに対応



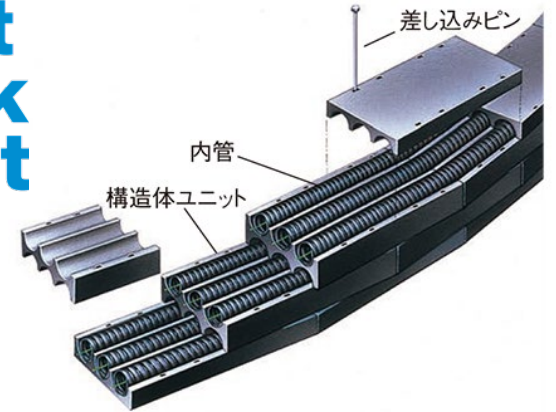
### SDBG/GAL用BGテープ

- ✓ ステルスダイシングプロセス (SDBG/GAL) 時のチップクラックを抑制
- ✓ 粘着物性のコントロールにより、高い追従性と軽剥離性の両立を実現
- ✓ 複雑な基材フィルム構成の設計により、業界最高水準の厚み精度を実現



\* HBM： High Bandwidth Memory

## データセンタ関連の次世代インフラシステムの工期短縮に貢献



- 内管と構造体ユニットの組立方式により従来方式で必須となるコンクリート養生期間が不要
- 優れた施工性により工期短縮を実現

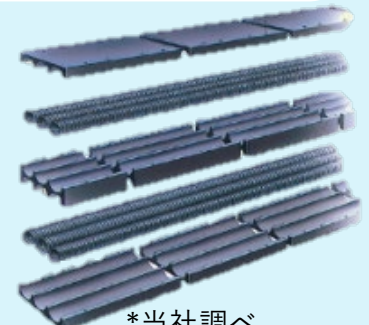
コンクリート巻方式と比較して工期**54%減\***

従来  
コンクリート方式



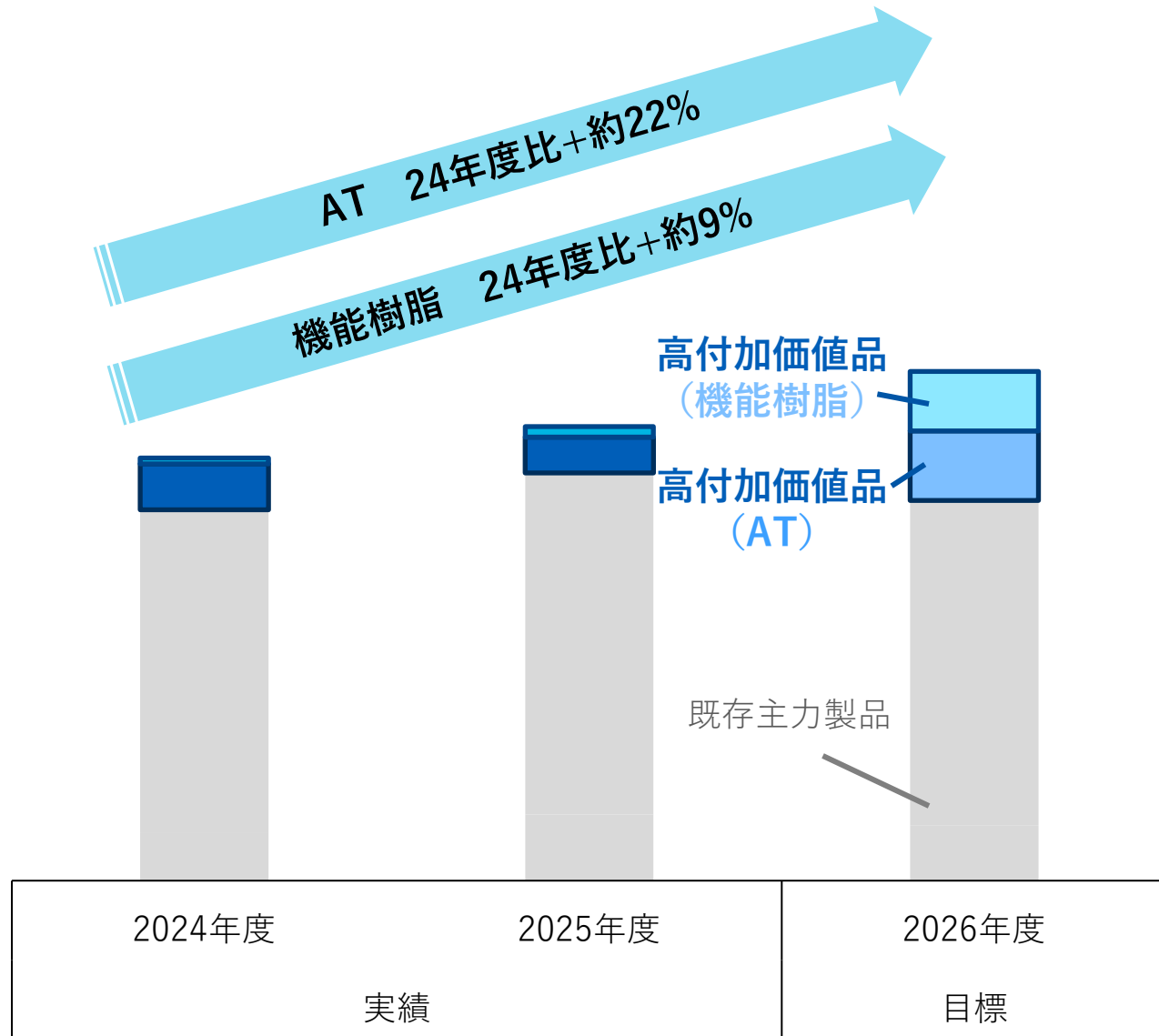
ダクトバンクLight

工期  
**54%減\***



\*当社調べ

# AT・機能樹脂： 売上高の推移



## Point

- ATは、AI向けHBMやGALに代表される半導体の最先端プロセス向けの売上拡大に注力
- 機能樹脂は、データセンタおよび通信基地局向けの売上拡大に注力

All to brighten the world

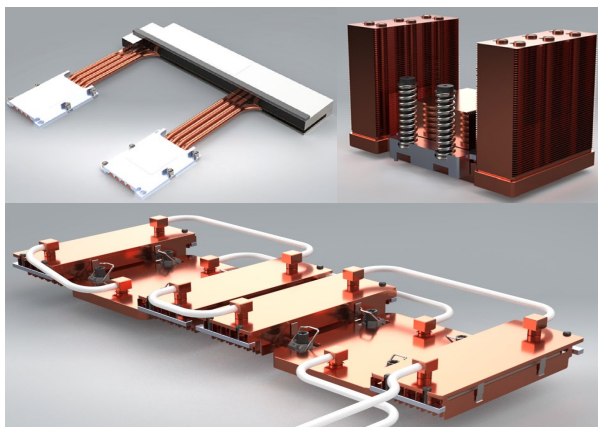
**FURUKAWA**  
ELECTRIC

# サーマル・電子部品事業

サーマル・電子部品事業部門長

川畑 賢也

## データセンタ向け冷却・放熱製品工場の立ち上げと拡張（水冷:平塚、FTL、FFT、空冷:FAZ、FTL） 顧客要求に沿ったロードマップ作成と高機能・差別化製品を開発、提供



### 水冷モジュール

今年度から本格的に適用される水冷ソリューションに対して開発、能力拡大

- 高性能コールドプレートや流路設計の最適化
- AI半導体から光トランシーバー・スイッチ・メモリなどの周辺素子まで対応

### 空冷ヒートシンク

今後も継続される空冷ソリューションに対して開発、能力拡大

- ヒートパイプ、3Dベーパーチャンバーなどの性能改善や工程改善
- 高発熱・高密度対応のデータセンタ向け半導体用ヒートシンクへの対応

### ケイパビリティ

- 水冷案件拡大に対応した工場拡張・新工場建設の決定と最適配置

FAZ: 中国のリソース/サプライチェーン活用

FTL: 水冷工場立ち上げ、工場拡張

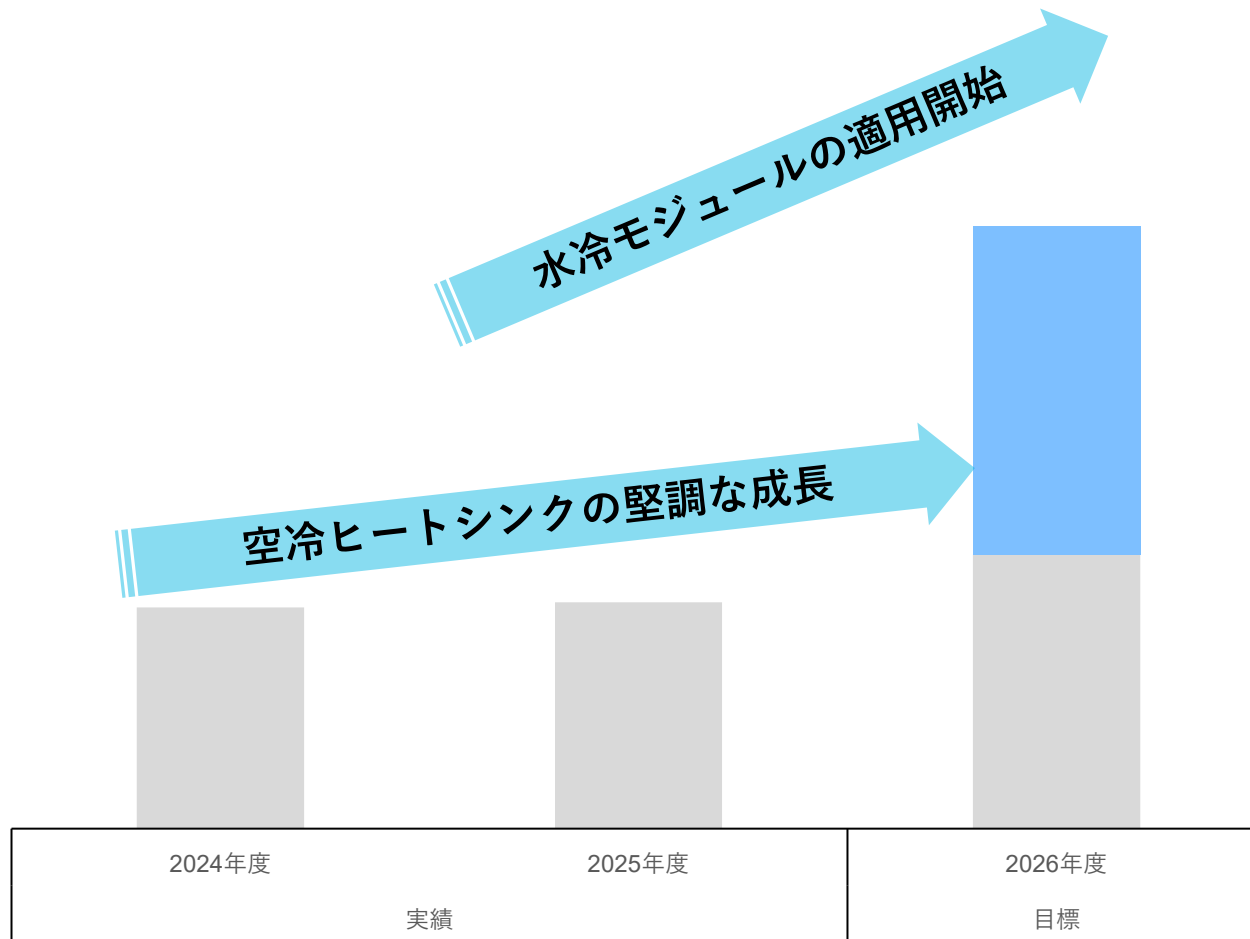
FFT: BCPも考慮した新設

- 空冷実績を基盤とした迅速な熱性能・構造設計提案による顧客課題解決

### サステナビリティ

- すべての工場において再生可能エネルギー由来電力を100%導入
- 社会インフラの安定稼働を支え、持続可能な社会に貢献

# サーマル・電子部品： 売上高の推移



## Point

- 2025年度もデータセンタ市場にて、生成AI用空冷ヒートシンクが大きく成長
- 2026年度以降は、水冷モジュールの本格量産が開始、売上的大幅増に期待
- 引き続き、差別化製品・サービスを提供し、収益拡大を図っていく

AI・データセンタ市場の急成長を捉え、持続的成長に大きく貢献

## 市場環境と背景

### 市場の継続的な成長

生成AIの普及に伴い、データセンタ用冷却関連市場は継続的に成長

### 発熱量の増加

生成AIの高度化に伴いGPU、TPUの発熱量が増加  
数百Wから、数千Wへ

### 冷却対象の増加

空冷ソリューションの継続に加え、AI半導体から光トランシーバ・スイッチ・メモリなどの周辺素子まで冷却対象が増加

## 投資・事業目標

### 投資総額\*

780億円

### 利益拡大

(2030年度目標/2025年度比)

15倍

\* 2024年度以降の増産投資金額

## グローバル生産体制の拡張

### 1) 水冷モジュール

拠点：FTL、FFT(新設)  
顧客、冷却対象、企画数量が増加したことに対応するため、FTLの水冷工場を再拡張  
BCPの観点からタイに新工場建設  
(2026年6月量産開始予定(FTL)、  
2028年1月量産開始予定(FFT))

### 2) 空冷ヒートシンク

拠点：FTL、FAZ  
CPU、GPU、スイッチ、ネットワークカードなどの空冷案件の増加に対応するため、FTL、FAZの空冷工場の能力増強  
(2026年7月量産開始予定)

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC

# メモリーディスク事業

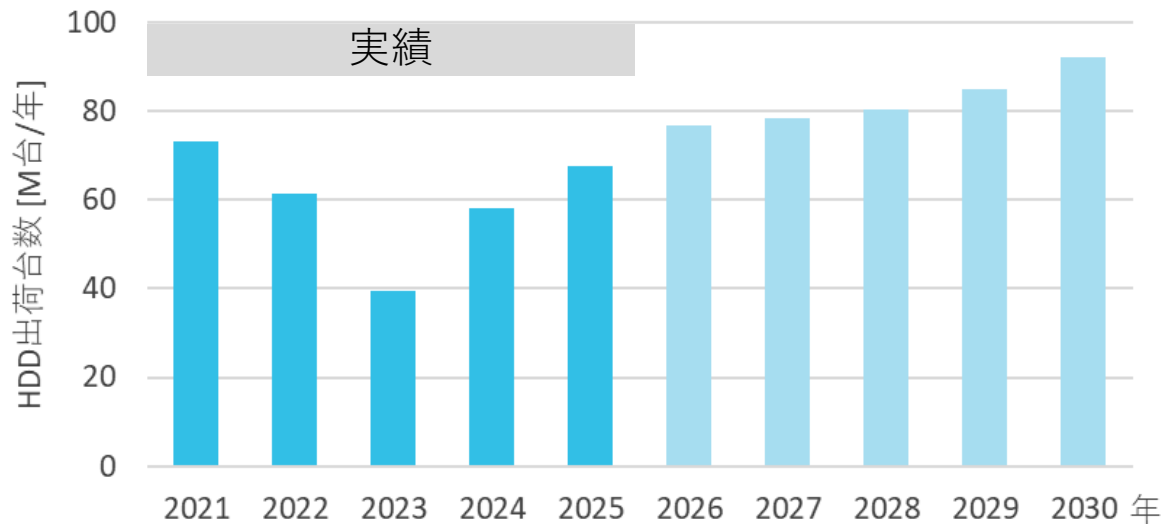
メモリーディスク事業部門長

森 高志

世界のデータ量増大を背景に、HDDは一台あたりの搭載枚数の増加が今後も進行し、基板の薄板化が必要

## 薄型化のお客様要求に差別化材料で応え続ける

### 【ニアライン向けHDD出荷台数】



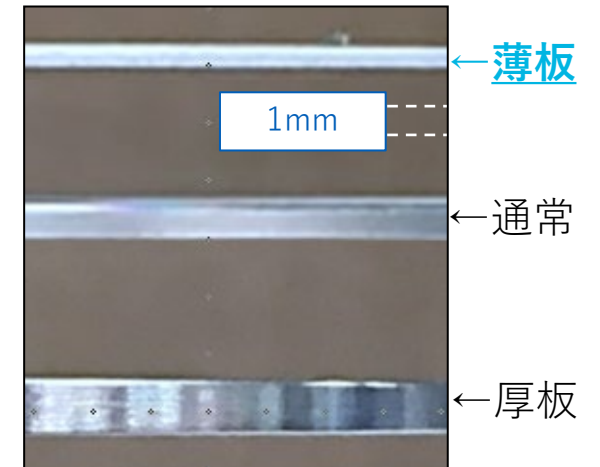
(調査会社情報をもとに当社作成)

### 【最新HDDの内部】



搭載枚数は増加を続け、2017年に最大8枚だったが、2024年に**11枚搭載**する製品が登場 (※写真は10枚搭載品)

### 【ブランク厚さ比較】

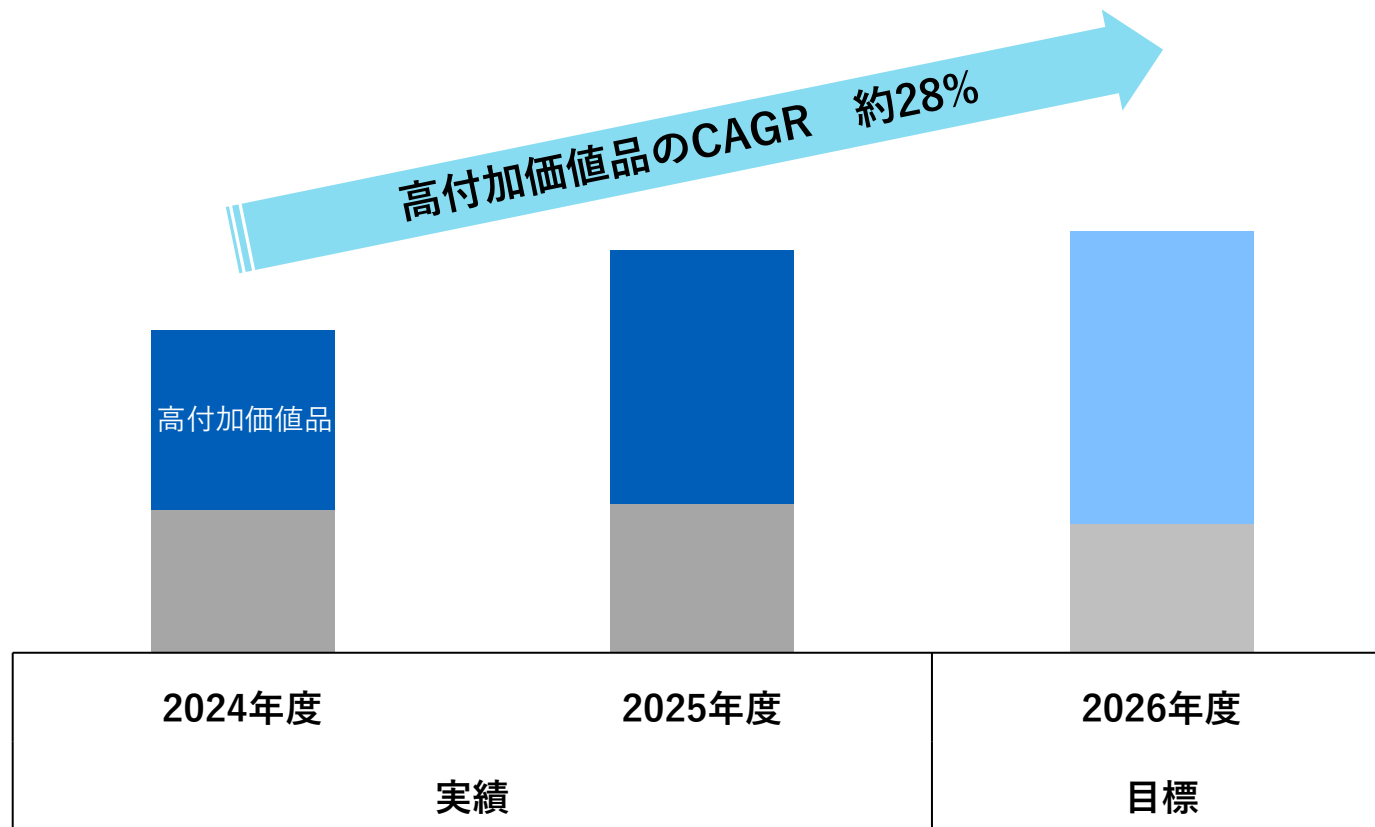


薄板は約1mm未満  
(写真は全て当社材)

# メモリーディスク： 売上高の推移

AI需要の高まりを背景に、2025年度は売上本格回復となった。当面強い需要が継続する見通しも、HDDメーカー各社の戦略\*により、やや高止まりして推移する予測となっている

\* 主要HDDメーカーはHDD台数増ではなく、1台当たりの記憶容量を高める技術により、容量需要増に対応する戦略



## Point

- 1台当たりの容量を高める技術革新への期待を背景に、基板のさらなる薄型化および品質要求が高まる
- 当社は差別化した新材料の上市により引き続き顧客ニーズに応じていく

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
**ELECTRIC**

# 銅箔事業

銅箔事業部門長

齊藤 孝史

# 銅箔： 事業展開

市場変化に合わせ、製品PF転換によりAIサーバ向けに注力、高付加価値品の増で事業成長を実現

従来



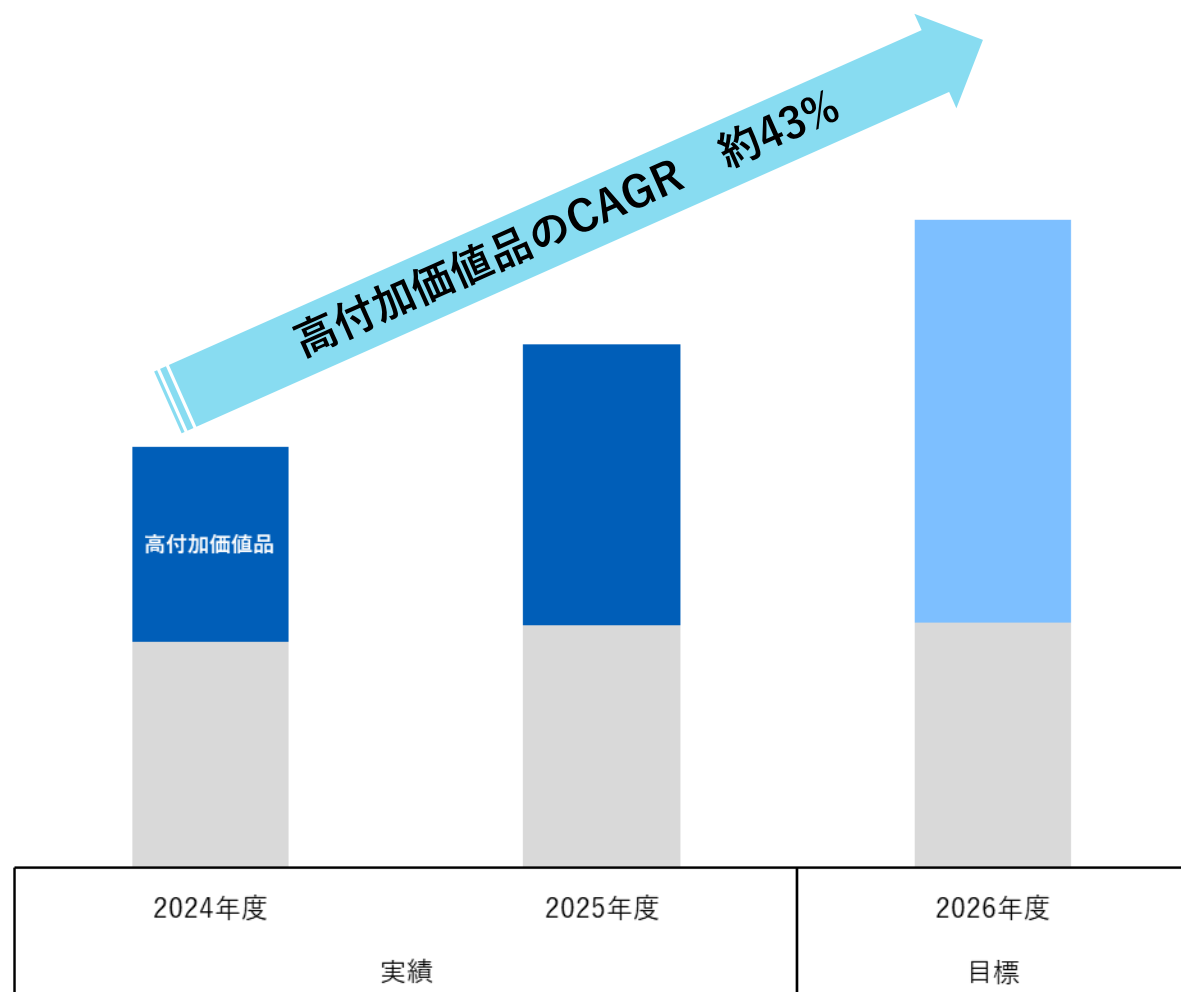
現在

市場の変化に合わせ製品PFを転換



\* HVLP銅箔: Hyper Very Low Profileの略で、主に高周波回路基板用途に用いられる、非常に低い表面粗さを持つ銅箔

2023年以降のAIサーバ需要増により HVLP銅箔が伸長、高付加価値品売上高比率増による利益増



## Point

主な高付加価値品は以下のとおり、特に HVLP銅箔 の売上を伸ばしていく

### HVLP銅箔

生成AIの伸長により、23年度以降需要が急拡大。高需要を見込む HVLP4クラス の銅箔に対し当社のFOX-WS箔を軸にこの需要に応え、世界のAIサーバ基板を支え、成長を実現



高周波FPC用銅箔  
電磁波シールド用途  
ハイエンドスマホに搭載、高性能化の波にのる



All to brighten the world

**FURUKAWA**  
**ELECTRIC**

# ファイテル製品事業

ファイテル製品事業部門長

小神野 毅

# ファイテル製品： 今後の事業展開

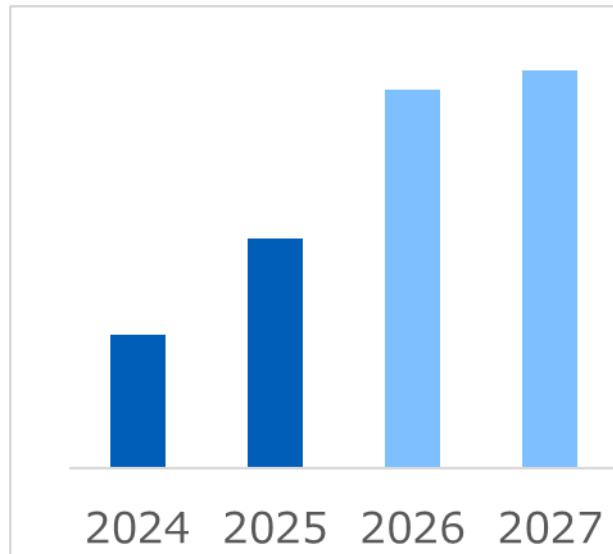
データセンタ需要拡大を背景に、技術力と供給能力により成長

## 市場動向

- ・ データセンタ内向け製品は需要増
- ・ データセンタ間向け製品も需要増

※需要拡大を背景に、供給能力確保が成長の前提

データセンタ向け光部品市場見通し



SignalAI等を基に当社作成

\*1 ELS : External Light Source

\*2 CPO : Co-Packaged Optics

\*3 SOA : Semiconductor Optical Amplifier

## DC内ソリューション

### ■DFBレーザチップ、ELS\*1

- ・ DC内高速化(400G/800G)に伴う光源の需要増加

### ■製造能力拡大

- ・ 急増する需要を取り込むための供給能力確保

### ■ 800G/1.6T向け高出力DFB/ELSの製品開発と拡販

- ・ CPO \*2向け次世代アーキテクチャでの採用拡大

## DC相互接続ソリューション

### ■ SOA\*3、ラマン増幅器用励起光源

- ・ DC間向けに増幅系光源の需要増加

### ■製造能力拡大

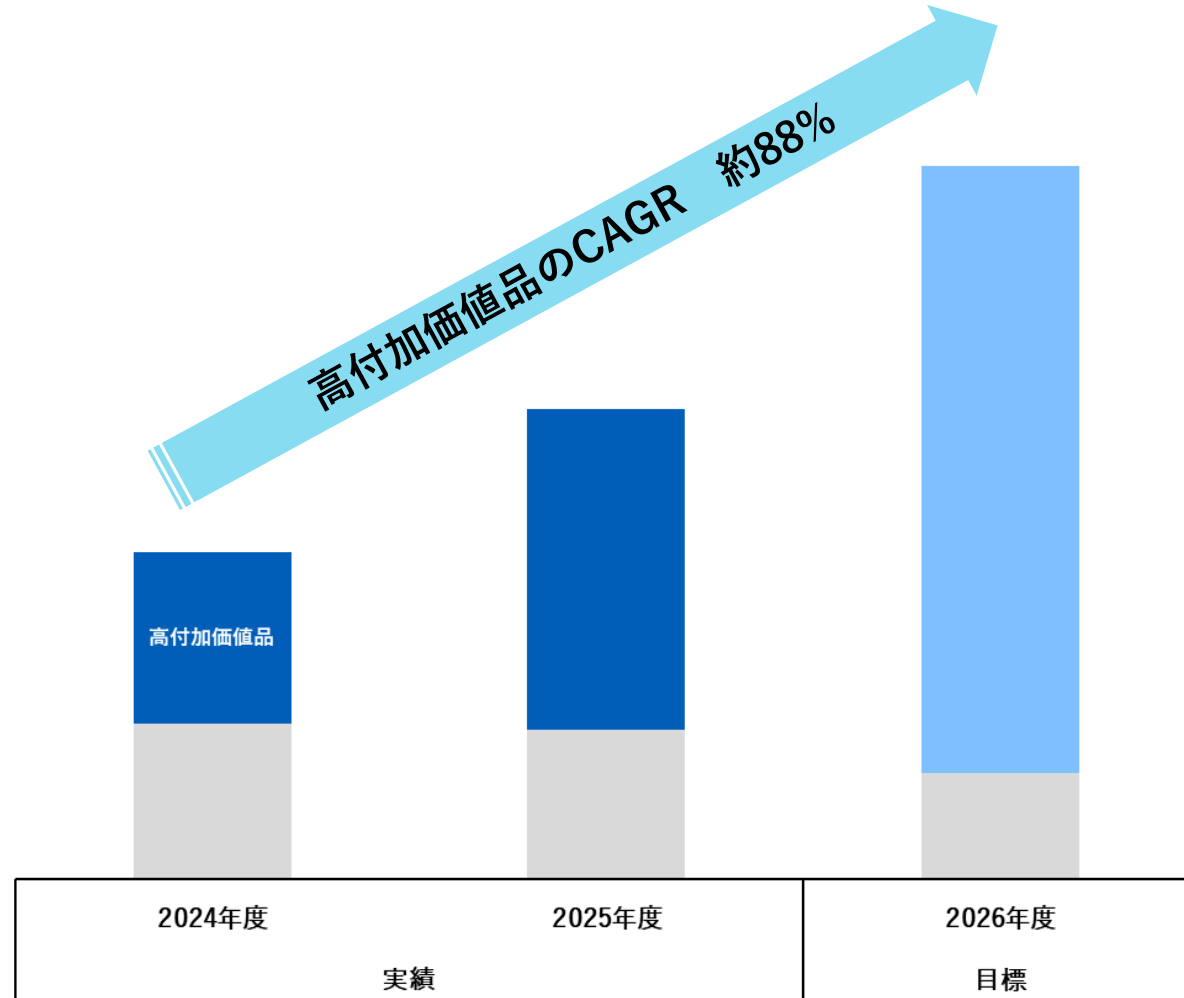
- ・ 高付加価値製品の安定供給体制の確保

### ■高出力・高信頼性を中心とした製品開発と拡販

- ・ 高性能要求分野での継続的な採用拡大

# ファイテル製品： 売上高の推移

DC内向けDFBに加え、DC間向けSOA、ラマン増幅器用励起光源の需要も取り込み、高付加価値品の売上が拡大



## Point

- DC内向けDFBレーザチップの需要拡大
- DC間向けSOA、ラマン増幅器用励起光源の採用拡大
- 成長投資により半導体レーザの生産体制を強化

# 2030年に向けた成長投資： ファイテル製品

急拡大する需要に対し、供給能力拡大により需要を取り込み、売上成長を実現

## 市場環境と背景

### 市場の爆発的な成長

- ・生成AIとクラウドサービスの普及により、データセンタの通信トラフィックが急増

### 通信の超高速化

- ・ネットワーク伝送速度は従来の400Gbpsから、800Gbps/1.6Tbpsへ

### 次世代技術「CPO」の発展

- ・広帯域化・省電力化を実現する次世代ネットワークスイッチ技術「CPO(Co-Packaged Optics)」の導入が加速の見通し
- ・外部光源として、高出力DFBレーザチップの需要が急拡大

## 投資・事業目標

### 投資総額\*

380億円

### 利益拡大

(2030年度目標/2025年度比)

10倍

\* 2025年度12月発表の増産投資金額

## グローバル生産体制の拡張

### 1) 前工程(ウェハプロセス)

- 拠点：FFOD岩手工場(新設)
- ・ジャパンセミコンダクター岩手事業所内に新設
  - ・東芝グループの半導体製造実績を持つ同社協力を得て、高効率で安定的な供給体制を確立  
(2028年4月量産開始予定)

### 2) 後工程(検査等チップ工程)

- 拠点：タイ工場(設備増強)
- ・Furukawa FITEL (Thailand)第二工場へ専用設備を導入
  - ・急増する需要を確実に捉えるサプライチェーンを確立  
(2026年2月竣工)

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC


# 光電融合デバイス事業

光電融合デバイス事業部門長

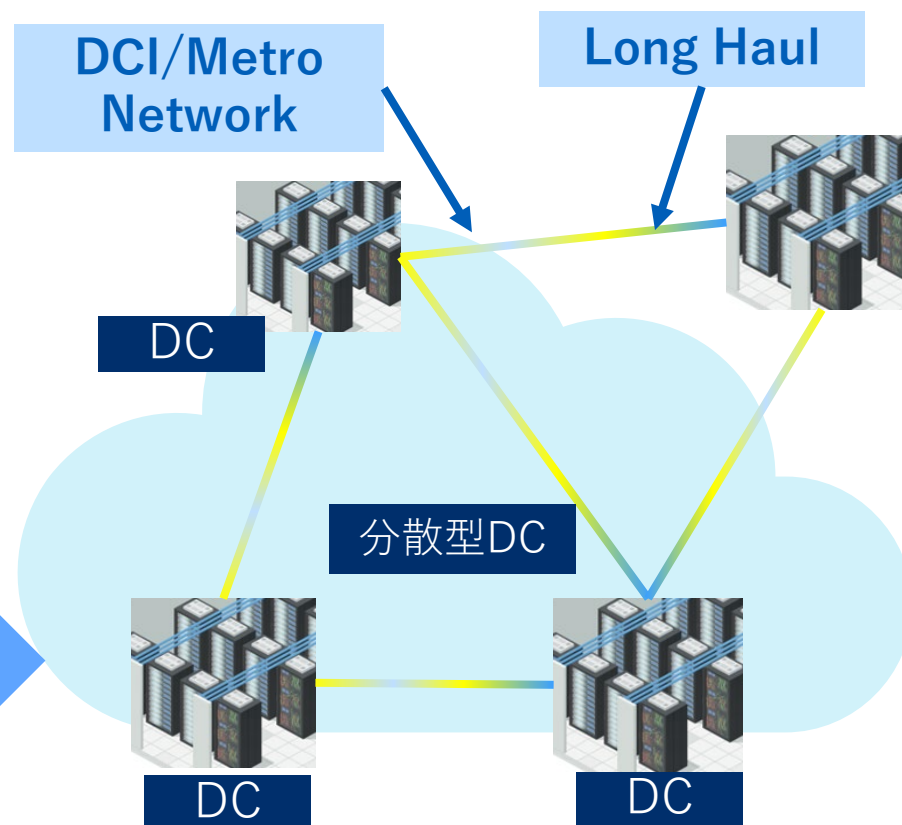
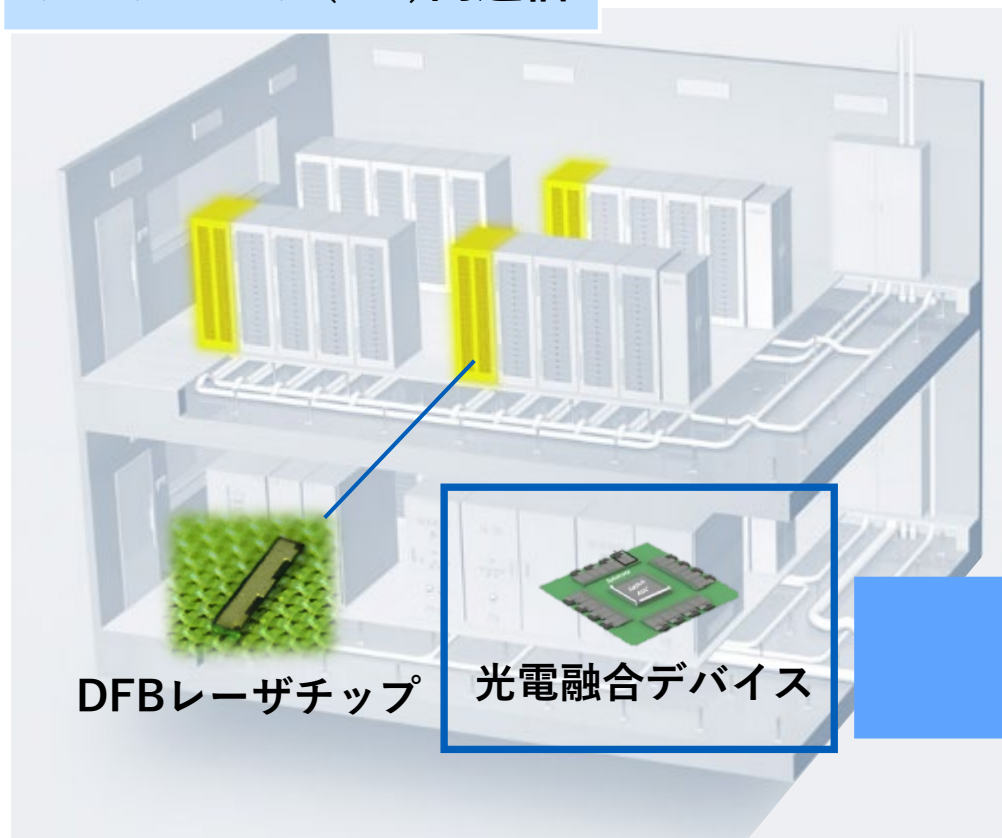
高木 啓史

# 光電融合デバイス： 今後の事業展開

新たな製品ポートフォリオとして変調器・トランシーバ等の高機能製品を加え、  
データセンタ市場の通信性能向上に貢献

 : 光電融合デバイス事業部門で開発している製品

## データセンタ(DC)内通信



薄膜LN変調器



トランシーバ



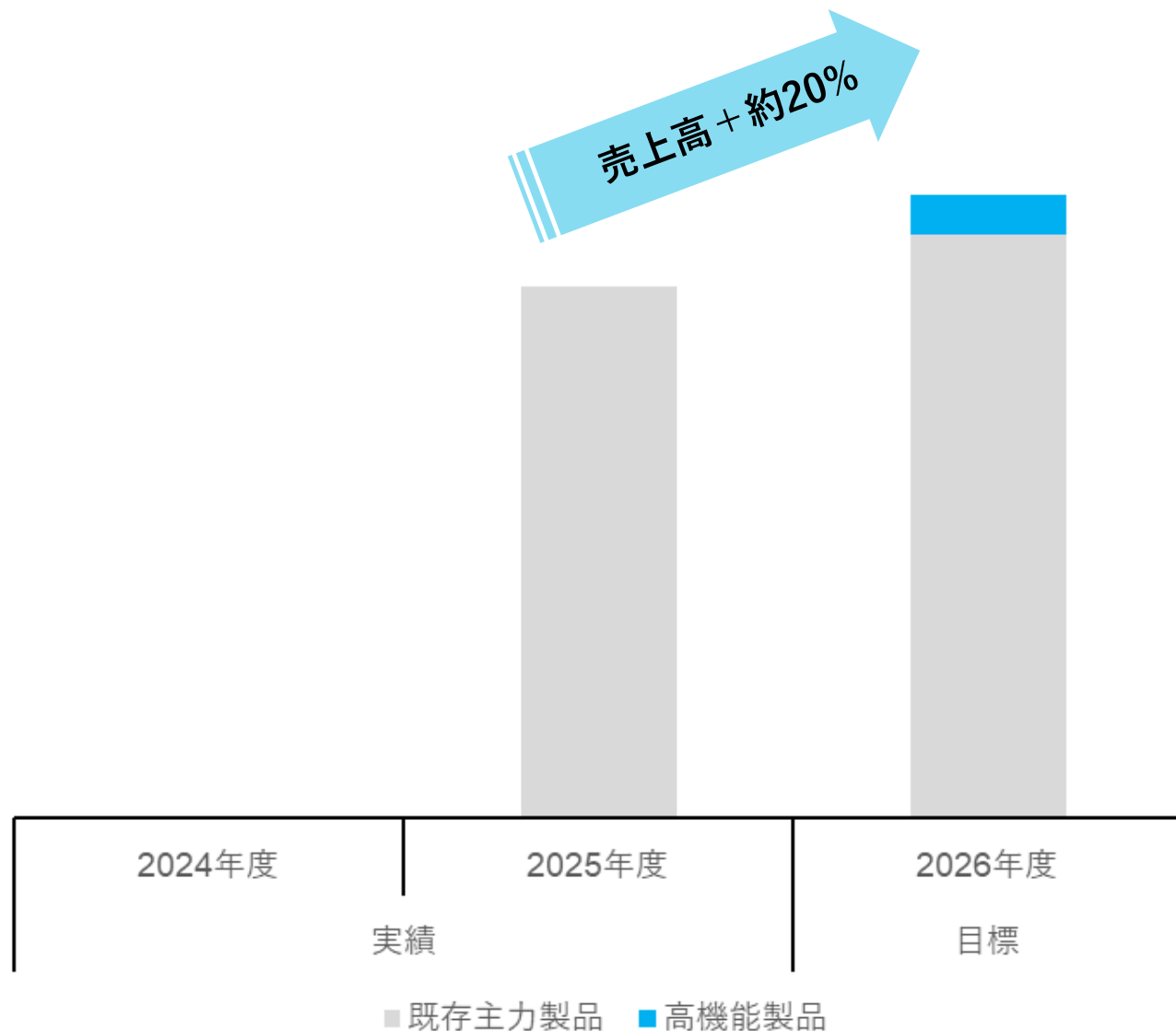
CDM\*



Nano ITLA

\* CDM : Coherent Driver Modulator

# 光電融合デバイス： 売上高の推移



## Point

- データセンタ需要は引き続き堅調。既存主力製品は着実に収益を上げていく。
- 2030年に向けては薄膜LNや1.6Tトランシーバ等の高機能製品を開発・拡販するとともに、次世代の光電融合デバイスの事業化を目指す。

All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC

ご清聴ありがとうございました

# Thank You

古河電工グループ パーパス

「つづく」をつくり、  
世界を明るくする。



All to brighten the world

**FURUKAWA**  
ELECTRIC

## 補足資料 - Appendix

補足資料 事業概要

補足資料 製品紹介

補足資料 売上高・営業利益推移

## 環境分析

### 事業環境(主な収益機会)

- 世界的なデータトラフィックの増加
- カーボンニュートラルなどの社会的課題の解決
- AI技術の普及、データセンターの拡大

### 強み

- 差別化された高い技術力・特許
- 技術・営業が一体となった迅速でキメ細かい顧客サービス力

### 事業環境(主なリスク・脅威)

- 地政学リスクによるサプライチェーンの供給不安
- インフレによる人件費、エネルギーコスト、原材料、輸送費高騰等

### 課題

- 技術差別化を生み出し続ける設計力・開発力の持続・向上
- 拠点最適化等によるBCPのさらなる高度化やカーボンニュートラル等環境負荷低減に向けた取組みのさらなる推進

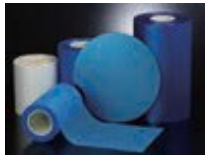

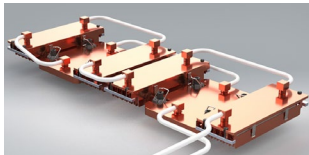
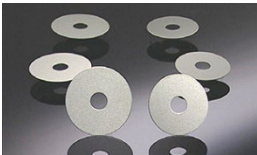
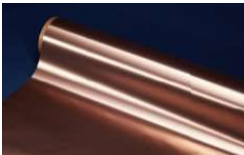
## ビジョン2030に向けた事業戦略

### 基本方針

- 「高機能」「差別化」製品で新分野・新顧客を取り込むことで成長していく。
- データセンター関連市場の変化に迅速に対応できる体制を構築する。

### 主な戦略

- AT・機能樹脂：AI半導体などの先端プロセス向け高付加価値品に集中。データセンター関連の次世代インフラシステムの工期短縮に貢献。
- サーマル・電磁部品：データセンター向け冷却・放熱製品工場の立ち上げ・拡張。高性能・差別化製品を開発し提供。
- メモリーディスク：HDD一台あたりの搭載枚数の増加に必要な基板の薄型化を差別化材料で実現
- 銅箔：AIサーバなどのデータセンター市場向けを軸に高品質な電解銅箔を世界市場に供給
- ファイテル製品：グローバル生産体制を拡張し、データセンター関連市場に高付加価値品を提供
- 光電融合デバイス：変調器・トランシーバ等の高機能製品でデータセンター市場の通信性能向上に貢献

貢献分野	AT*・機能樹脂		サーマル・電子部品	メモリーディスク	銅箔
製品写真					
データセンタ	●	●	●	●	●
カーボンニュートラル			●		
インフラ強化	●	●	●		●
モビリティ (自動運転・電動化)		●	●		●
主な製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半導体製造用テープ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ケーブル保護管</li> <li>● リサイクルトラフ</li> <li>● 断熱材</li> <li>● 高機能フォーム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高性能ヒートシンク・ヒートパイプ、3Dベーパーチャンバー、水冷モジュールなどの放熱製品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDD用アルミブランク材</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 回路基板用電解銅箔</li> <li>● 電池用電解銅箔</li> </ul>
主な用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半導体ウエハの加工工程での、表面保護や固定など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地中埋設ケーブル保護管</li> <li>● ケーブル格納用トラフ</li> <li>● 空調配管用断熱材</li> <li>● 基地局向け基板</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データセンタサーバ用のCPU、GPUなどの冷却</li> <li>● データセンタサーバ用のOptics、Switch、DIMM、VRMなどの周辺装置の冷却</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データセンタや監視カメラ用途などのHDD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AIサーバ、通信サーバなどのハイエンドサーバや、スマートフォン、PCなどの電子機器の回路基板</li> <li>● リチウムイオン電池の負極材</li> </ul>
主な顧客	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半導体メーカー</li> <li>● ファウンドリメーカー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ゼネコン・サブコン</li> <li>● 鉄道会社、道路公団・道路サブコン</li> <li>● 空調配管メーカー</li> <li>● RANベンダー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データセンタハイパースケaler</li> <li>● 生成AIチップ、光モジュールメーカー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDDサブ基板メーカー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 回路基板材料メーカー</li> <li>● リチウムイオン電池メーカー</li> </ul>

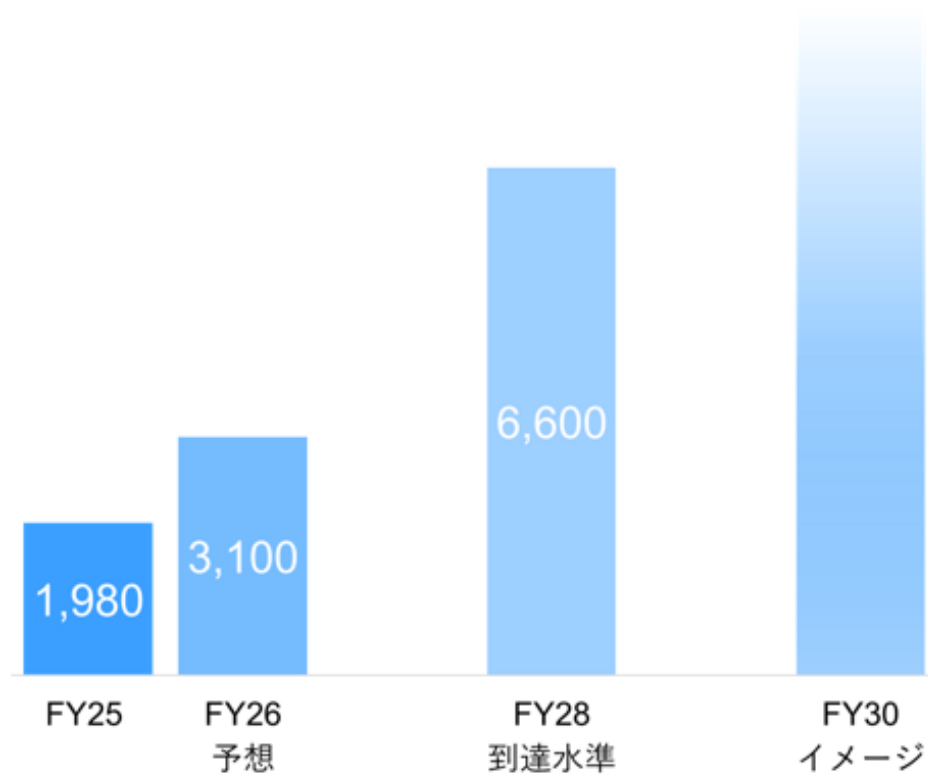
\*AT : Advanced Technology Tape

貢献分野	ファイテル製品	光電融合デバイス
製品写真		
データセンタ	●	●
カーボンニュートラル	●	●
インフラ強化	●	●
モビリティ (自動運転・電動化)		
主な製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DFBレーザチップ</li> <li>● 波長可変レーザモジュール</li> <li>● 励起用レーザモジュール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 光送受信デバイス</li> <li>● 光トランシーバモジュール</li> <li>● 光変調器</li> </ul>
主な用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● データセンタ向け大容量通信</li> <li>● デジタルコヒーレント信号光源</li> <li>● 信号光増幅用励起光源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通信事業者向け高速通信</li> <li>● データセンタ向け大容量通信</li> </ul>
主な顧客	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システムベンダー</li> <li>● 伝送装置メーカー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通信事業者</li> <li>● システムベンダー</li> <li>● 伝送装置メーカー</li> </ul>

# Appendix 売上高・営業利益推移

## 売上高

(億円)



## 営業利益

(億円)

